

证券代码:301095 证券简称:广立微 公告编号:2024-015

杭州广立微电子股份有限公司

2023年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告审计机构对本公司年度报告的审计意见为:标准的无保留意见。

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 公司简介, 2. 报告期主要业务或产品简介) and Content (e.g., 1.1 公司简介, 1.2 报告期主要业务或产品简介).

3. 高级管理人员及核心技术人员的变动情况
3.1 高级管理人员变动情况
报告期内,公司高级管理人员变动情况如下:
李国君先生辞去副总经理职务,由王宇先生接任。

3.2 核心技术人员的变动情况
报告期内,公司核心技术人员的变动情况如下:
王宇先生辞去副总经理职务,由李国君先生接任。

4. 主要业务或产品简介
4.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

4.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

5. 主要财务数据和财务指标
5.1 主要财务数据
单位:元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减 |

5.2 主要财务指标
(1) 盈利能力指标
(2) 偿债能力指标
(3) 运营能力指标

6. 主要业务或产品简介
6.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

6.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

7. 主要业务或产品简介
7.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

7.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

8. 主要业务或产品简介
8.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

8.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

9. 主要业务或产品简介
9.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

9.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

10. 主要业务或产品简介
10.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

10.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

11. 主要业务或产品简介
11.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

11.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

12. 主要业务或产品简介
12.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

12.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

证券代码:300967 证券简称:晓鸣股份 公告编号:2024-030

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2023年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 公司简介, 2. 报告期主要业务或产品简介) and Content (e.g., 1.1 公司简介, 1.2 报告期主要业务或产品简介).

3. 高级管理人员及核心技术人员的变动情况
3.1 高级管理人员变动情况
报告期内,公司高级管理人员变动情况如下:
李国君先生辞去副总经理职务,由王宇先生接任。

3.2 核心技术人员的变动情况
报告期内,公司核心技术人员的变动情况如下:
王宇先生辞去副总经理职务,由李国君先生接任。

4. 主要业务或产品简介
4.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

4.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

5. 主要财务数据和财务指标
5.1 主要财务数据
单位:元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减 |

5.2 主要财务指标
(1) 盈利能力指标
(2) 偿债能力指标
(3) 运营能力指标

6. 主要业务或产品简介
6.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

6.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

7. 主要业务或产品简介
7.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

7.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

8. 主要业务或产品简介
8.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

8.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

9. 主要业务或产品简介
9.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

9.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

10. 主要业务或产品简介
10.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

10.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

11. 主要业务或产品简介
11.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

11.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。

12. 主要业务或产品简介
12.1 主要业务
公司主要从事集成电路封装测试设备、封装材料、封装耗材的研发、生产和销售。

12.2 主要产品
公司主要产品包括:封装测试设备、封装材料、封装耗材等。